



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100226002

2010 年 3 月 30 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☒ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	6 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：一部製品について、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、現行 Au(金)線 ボンディングワイアに替わり、Cu(銅)線 ボンディングワイアへの移行を認定しました。現行の製造サイト及びボンディングワイア部材以外の変更はございません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
ボンディングワイア

現行
Au(金)線

変更後
Cu(銅)線

理由：機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

対象製品リスト

対象製品名				
BQ24901PW	TLC5947DAP	TPA3007D1PWRG4	TPS40021PWR	TPS65105PWPG4
BQ24901PWG4	TLC5947DAPG4	TPA6030A4PWP	TPS40021PWPRG4	TPS65105PWR
DRV104PWP	TLC5947DAPR	TPA6030A4PWPG4	TPS61100PW	TPS65105PWPRG4
DRV104PWPG4	TLC5947DAPRG4	TPA6030A4PWR	TPS61100PWG4	TPS65140PWP
DRV104PWPR	TLS2502ADCARG4	TPA6030A4PWPRG4	TPS61100PWR	TPS65140PWPG4
DRV104PWPRG4	TLS2502BDCARG4	TPS2211APWP	TPS61100PWPRG4	TPS65145PWP
HPA00082PWR	TLS2502DDCARG4	TPS2211APWPG4	TPS61120PW	TPS65145PWPG4
HPA00304PWR	TLS2502EDCARG4	TPS2211APWR	TPS61120PWG4	TPS65145PWR
SN65HVS880PWP	TLS2502TDCARG4	TPS2211APWPRG4	TPS61120PWR	TPS65145PWPRG4
SN65HVS880PWPG4	TLS2503BDCARG4	TPS2211APWR	TPS61120PWPRG4	TPS65150PWP
SN65HVS880PWR	TPA3001D1PWP	TPS2211APWPRG4	TPS65100PWP	TPS65150PWPG4
SN65HVS880PWPRG4	TPA3001D1PWPG4	TPS40020PWP	TPS65100PWPG4	TPS65150PWR
SN65HVS882PWP	TPA3001D1PWR	TPS40020PWPG4	TPS65100PWR	TPS65150PWPRG4
SN65HVS882PWPG4	TPA3001D1PWPRG4	TPS40020PWR	TPS65100PWPRG4	
SN65HVS882PWR	TPA3007D1PW	TPS40020PWPRG4	TPS65101PWR	
SN65HVS882PWPRG4	TPA3007D1PWG4	TPS40021PWP	TPS65101PWPRG4	
SN84001PWR	TPA3007D1PWR	TPS40021PWPG4	TPS65105PWP	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 12 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA3007D1PW	Die Sizes (mm):	2.082 X 4.184	
Die Protective Coating:	10KACN		-	-
Assembly Site:	TAI/TITL	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/24	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC, LEVEL2-260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Thermal Shock	-65/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77/0	77/0	77/0
High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	Approved	Approved	Approved
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-2 / 260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 12 月 15 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA6030A4PWP	Die Sizes (mm):	1.914 X 3.762	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TAI/TITL	Package/Code/Pins:	HTSSOP/ PWP/28	
Mount Compound:	4206201	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC, LEVEL4-260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Thermal Shock	-65/150C, 500 Cycles		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs.		77/0	
High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.		77/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles		77/0	
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec		Approved	
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-4 / 260C				